

Hi3516AV300 功耗测试报告

文档版本 00B01

发布日期 2019-06-03

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何 形式传播。

商标声明



(A) THISILICON 、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不做 任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指 导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限公司

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com/cn/

客户服务邮箱: support@hisilicon.com

前言

产品版本

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
Hi3516A	V300

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

- 技术支持工程师
- 单板硬件开发工程师

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本 00B01 (2019-06-03)

第1次临时版本发布。

目录

前	音	i
	i3516AV300 功耗测试结论	
	1.1 Hi3516AV300 功耗测试环境及说明	
	1.2 功耗测试场景以及相应的功耗数据	
	1.2.1 场景 1: 智能业务+媒体业务	1

【 Hi3516AV300 功耗测试结论

注意

本测试报告仅用于分享基于当前测试样本和环境的客观记录,从而为客户自行测试做一定程度的参考,测试结果不代表对任何规格、功能、性能等的承诺,也不具备任何约束力。如有疑问,可核对芯片手册。

1.1 Hi3516AV300 功耗测试环境及说明

测试对象	HI3516AV300DMEB 单板		
摄像头	IMX334		
测温设备	点温计		
加温设备	高低温箱,测试温度为芯片结温约 65℃和 105℃		
主芯片散热方式	单板放置于温箱中,依靠 PCB 和芯片表面对流散热。		

1.2 功耗测试场景以及相应的功耗数据

1.2.1 场景 1: 智能业务+媒体业务

智能业务

开启 NNIE 业务(VGG16 全速跑)。

媒体业务

- 模式: Vi 在线 Vpss 离线;
- VI: 3840*2160@30fps 输入 + 2 合一行模式 WDR + PIPE 开启行压,通道开启段压 +ISP 开启 DE, VI 送 VPSS。
- Vpss: 3 个通道非压输出 (3840*2160@30fps+1024*576@20fps+720*480@20fps), 0 通道压缩输出,其他 两个通道非压缩输出+ 开启 VPSS 的 NR, Vpss 送编码和 Vo 预览,送 IVSMD720*576@10fps。
- VO为 HDMI 时序的预览。
- VEDU: 3 路 H26x 编码(H265 SmartP 3840*2160@20fps 40Mbps + H264 NormalP 1024*576@20fps 1Mbps + H264 NormalP 640*360@20fps 512Kbps)+ 一路 Jpeg 编码(3840*2160@2fps)大码流存 SD 卡+JPEG 抓拍存 SD 卡
- 2 路大码流点播+2 路中码流点播。
- 音频: 1 路音频 32K 采样率 16bit 位宽 AAC 协议开 AGC、ANR 和 AEC;
- 频点: CPU:900/ VICAP:396/ VIPROC:300/ VPSS:300/ VGS:475/ VEDU:300/ JPGE:396/ NNIE:550/ IVE:475/ VDP:300/ DDR:900。

表1-1 各个温度节点下的场景 1 功耗数据

芯片结温	Core 功耗(mW)	VDDIO_DDR (mW)	DVDD18 (mW)	DVDD33 (mW)	总功耗 (mW)
	DVDD				
66℃	1032	398	18	144	1592
105℃	1670	424	26	145	2265

备注: DDR 占用率约 70%, CPU 的占用率都是约 95%。